

每周热点

需求持续及获政策支持

料有利内地半导体行业表现

2025年09月30日 中国工商银行(亚洲)证券业务部

内地对半导体的需求持续增长，加上内地推出不同措施，进一步推动内地半导体产业的发展。此外，内地半导体出口到海外的表现持续理想。因此，预料内地半导体行业表现强劲。

内地对半导体的需求持续增长

内地及全球对半导体的需求于今年上半年维持较快增长。据美国半导体行业协会（SIA）资料，内地今年上半年的半导体销售金额达 517 亿美元（下同），同比增长 13.1%，占全球销售金额的 28.8%。根据部分企业的公告显示，第二季半导体产能使用率达到 108.3%，表现产能未能满足需求。据资料研究机构弗若斯特沙利文估计，内地芯片市场规模由 2024 年至 2028 年间的年复合增长率达 8.8%，到 2028 年将达到 14,410 亿元人民币（下同）。由此证明，内地对半导体的需求持续殷切。

内地推出政策利好半导体行业

中国国务院于今年 8 月印发《深入实施「人工智能+」行动的意见》，指出要求到 2027 年内地智能半导体的普及率超过七成，去到 2030 年，有关普及使用率要超过九成。另外，中国工业和信息化部及国家市场监督管理总局印发《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》，提出加快重大项目建设，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，保障产业链供应链坚定不移地推动「国货国用」，持续推动短板产业补链。另外，《2025 年国家网络安全宣传周网络安全企业家座谈会》于今年 9 月 15 日举行。中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任杨建文表示，龙头企业需扛起「卡脖子」技术攻关责任，聚焦半导体等关键领域，联合高校院所打造创新联合体，加速研发自主可控安全半导体以突破垄断。由此可见，内地推出利好政策，以支持半导体行业的发展。

内地半导体出口表现持续理想

除了内需外，内地半导体出口表现亦持续理想，主要受惠于全球对半导体的强劲需求所带动。据 SIA 的资料显示，今年第二季全球半导体销售金额达 1,797 亿美元，按年升 19.6%，按季升 7.8%，是连续第七个季度录得按年增长。据中国海关总署公布，今年上半年内地半导

体出口金额为 6,502 亿元人民币（下同），按年增长 20.3%，相当于每日出口 36 亿元，创历史新高，亦是连续第七季录得同比增长。至于半导体出口数量达 1677 亿个，按年升 20.6%，即平均每日出口 9.32 亿个，亦创历史新高。由于内地半导体生产质素理想，故市场预料内地半导体代工份额将在 2030 年时达到全球的三成。因此。预料内地半导体出口将持续表现理想，利好行业前景。

资料来源：美国半导体行业协会（SIA）、弗若斯特沙利文、中国国务院、《深入实施「人工智能+」行动的意见》、中国工业和信息化部、国家市场监督管理总局、《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》、《2025 年国家网络安全宣传周网络安全企业家座谈会》、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家互联网信息办公室、中国海关总署

——中国工商银行(亚洲)证券业务部分析员叶泽恒

利益披露：

本文的作者为香港证监会持牌人，分析员本人或其联系人仕并未涉及任何与该报告中所评论的上市公司的金钱利益或担任该上市公司的任何职务，而在编制的过程中分析员会根据预先订立的程序及政策，去避免因研究工作可能会引起利益冲突情况。

本行的高级职员、董事及雇员可能会持有本文件所述全部或任何该等证券或任何财务权益，包括证券及相关的衍生工具或财务通融安排。

免责声明：

本文的预测及意见只作为一般的市场或个别股份的评论，仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有，在未经本行同意前，不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容，本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。

本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成，惟该等资料的来源未有经独立核证，资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性，以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺，本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。而本文中的预测及意见乃本行分析员于本文刊发时的意见，本行可随时作出修改而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例，则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。

本文不构成任何要约，招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此，投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。此宣传档所载资料并非亦不应被视为投资建议，亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发，内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

风险披露：

投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。